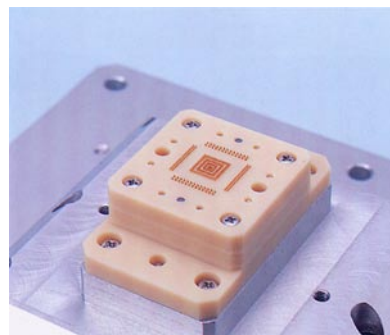
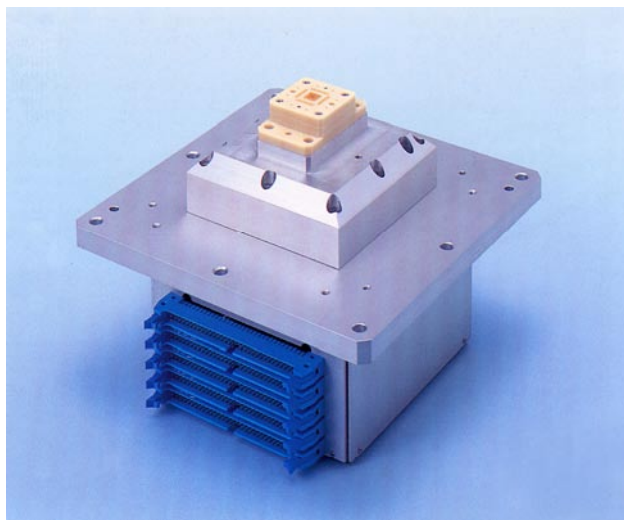


MCM/パッケージ基板検査用テストヘッド

MCM / IC Substrate Test Head

yokowo



MCM/パッケージ基板検査用テストヘッド

用途

- ・マルチチップモジュール、シングルチップ及びパッケージ基板のオープンショート検査
および抵抗測定検査

特長

- ・高耐久、高性能プローブ方式採用による安定した抵抗値
- ・安定した接触圧により基板へのダメージを削減
- ・コンタクトプローブ方式にて最小ピッチ0.1mmを実現
- ・メンテナンス性を重視したプローブ交換方式を採用
- ・0.15mm～0.9mm以上ピッチまでの6種類のプローブを混載することによる大幅なコストメリット

仕様

	150μm ピッチ テストヘッド	100μm ピッチ テストヘッド
テストヘッド材質	セラミック / スーパーエンブラ	セラミック / スーパーエンブラ
基本構造	お客様仕様による	お客様仕様による
プローブ先端位置精度	± 0.02mm 以下	± 0.01mm 以下
プローブ最大ストローク	0.6mm	0.3mm
絶縁抵抗	100MΩ 以上	100MΩ 以上
プローブ種数	φ0.11mm ~ 0.72mm (6種)	φ0.075mm only
バネ圧 (2/3ストローク時)	0.05N ± 0.02N ~ 0.1N ± 0.02N (depend upon probe size)	0.06N ± 0.01